

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

## 中巨芯科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	海通证券 东吴基金 富安达基金 广发基金 东方基金 红杉中国 源乘投资 华宝基金 贵诚信托 南华基金 浦银安盛 博笃投资 晨燕资管 峰境私募 峰岚资管 途灵资管 远策投资 智尔投资 澳亚基金 兴证全球 玄元私募 循远资管 长见投资 长盛基金 中欧基金 中银国际资管 中银基金 中信建投 长江证券 Hel Ved Capital Management Limited Willing Capital Management Limited Ikaria Group (HK) Limited China Merchants Fund Management Company, Limited
时间	2024年10月28日
地点	电话交流会
上市公司接待人员姓名	总经理：陈刚 副总经理：陈东强 财务负责人：孙琳 董事会秘书：陈立峰
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、公司介绍：</b> 介绍公司整体情况等。 <b>二、问答环节主要内容：</b> <b>Q：公司电子湿化学品、电子特气和前驱体材料，前三季度的销售情况？分产品看，不同产品的毛利率如何？</b> <b>A：报告期内，公司电子湿化学品销售约占75%，电子特气及前驱体材料销售约占25%，就毛利率情况来看，总体相对稳定，因为公司仍有部分产品处于市场导入阶段，因此整体看公司的</b>

电子湿化学品、电子特气及前驱体材料的毛利率水平低于同行水平。如换个角度看，公司已经稳定量产的产品均与同行平均水平相当。

**Q: 前驱体新产品或在研产品的进展情况？**

A: 在前驱体材料方面，目前公司已量产的前驱体材料有硅基的 HCDS、BDEAS 和金属基的 TDMAT。通过客户需求深入的对接，公司近期先后完成了硅基类如 BDEAS、TSA、DIPAS 工艺优化；开展了金属基类如 Hf（铪）、Zr（锆）等高 K 介电材料的前驱体材料的制备，提纯技术的积极探索和工艺开发。

**Q: 请问 2024 年四季度经营情况展望？**

A: 公司前三季度实现营业收入 7.49 亿元，较上年同期增长 15.47%。在半导体板块逐步复苏的大背景下，公司正在积极抢抓行业机会，努力提升产品市占率，整体经营情况稳中有升，具体信息还请关注公司后续披露的定期报告。

**Q: 公司产品的毛利率水平是否稳定？以及行业的竞争格局？**

A: 首先，今年初公司产品毛利因市场行业竞争态势有一次较大的下滑，在上次中报交流时也曾说明；在此之后，公司产品的毛利率相对稳定。当前公司产品所处的行业竞争格局和国内半导体行业的竞争格局息息相关，都相对比较“内卷”。

**Q: Heraeus 半导体高纯石英的市场容量及行业的竞争格局？及标的公司的研发、生产制造全球布局？**

A: 标的公司是一家全球领先的半导体高纯石英材料制造商，在全球范围内为半导体及光学行业提供天然熔融石英和合成熔融石英等产品，主要应用于半导体刻蚀设备、沉积设备以及计量与光学设备等，能够为全球半导体和光电子行业提供系统解决方案。据当前所了解的信息，标的公司的产品技术水平处于国

	<p>际领先水平，有较强竞争力。</p> <p><b>Q: Heraeus 公司收购后，市场、供应商是否存在巨大变化的风险？</b></p> <p>A: 当前该标的公司的收购事项，已通过英国主管部门审核。从市场层面看，标的公司位于英国沃尔森德，销售网络服务于全球市场，为欧洲、美国及日本等半导体设备厂商提供专业化产品和服务；从客户层面看，其客户端主要是半导体设备厂商，更加关注标的公司在新股东的引导下，能否提供更好的产品、更优质的服务。因而总体来看，收购后标的公司上述风险较小，生产经营有望平稳过渡。</p> <p><b>Q: Heraeus 公司收购进度及相关的经营节点？</b></p> <p>A: 该交易尚需通过我国主管部门审查批准，之后公司将积极推进交割过渡，并争取在交割后 12 个月内实现标的公司生产经营稳妥过渡。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 10 月 29 日